

Kupferschichten



Abscheidung, Eigenschaften, Anwendungen Von Prof. Dr.-Ing. habil. N. Kanani und einem Autorenteam. Erste Auflage 2000. 360 Seiten.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 102,80 €

110,00 €

Netto-Preis: 102,80 €

Enthaltene MwSt.: 7,20 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Kupfer ist nicht nur eines der ältesten von Menschen verwendeten Metalle, sondern eines der ersten Metalle, das galvanisch abgeschieden wurde. Ob in Galvanoformung, Kunststoffbeschichtung, Zylinderherstellung, für Leiterplatten, als Zwischenschicht oder Dekoration: nahezu jede Galvanik hat Kupferelektrolyte im Einsatz.

Im Zuge zahlreicher neuer Anwendungen wächst die Zahl der Betriebs- und Lohngalvaniken, die funktionelle Kupferschichten hoher Qualität abscheiden. Für diese anspruchsvolle Aufgabe benötigen sie nicht nur Kenntnisse über die Abscheidungsverfahren, sondern müssen möglichst umfassend über Lieferanten von Verfahren, Anlagen und Zubehör für die Technologie informiert sein.

Ähnliche Bedürfnisse haben auch Anwender, welche die Eigenschaften von Kupferschichten in ihren Erzeugnissen nutzen, sowie Institutionen und Schulen, die in Entwicklung und Lehre mit diesen Problemen befasst sind.

Dies soll das Buch vermitteln, das für alle bestimmt ist, die sich mit der Erzeugung und Anwendung galvanischer Kupferüberzüge befassen.

Aus dem Inhalt:

- Kupfer und seine Eigenschaften
- Elektrolytische Kupferabscheidung
- Technologie der elektrolytischen Abscheidung von Kupfer und -legierungen
- Eigenschaften von Kupfer und -legierungsabscheidungen

- Anwendung von elektrolytisch abgeschiedenen Kupfer und -legierungsschichten
- Außenstromlose abgeschiedene Kupferschichten
- Eigenschaften von außenstromlos abgeschiedenen Kupferschichten
- Qualitätssicherung, Analytik und Prozessoptimierung bei der Kupferabscheidung
- Entfernung (Strippen) von Kupfer und -legierungsschichten
- Recycling und Abwasserbehandlung
- Zur Entsorgung von Abfällen
- Kupfer in der Mikrotechnik
- Verkupferung in der Leiterplattentechnik
- Normung